

# ◆微小試料の研磨の紹介

対象試料:ピンプローブ系  
試料サイズ:150 $\mu$ ~300 $\mu$   $\phi$   
研磨面:断面、平面



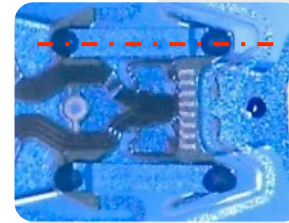
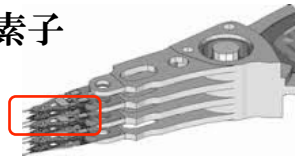
アクリル板に挟む



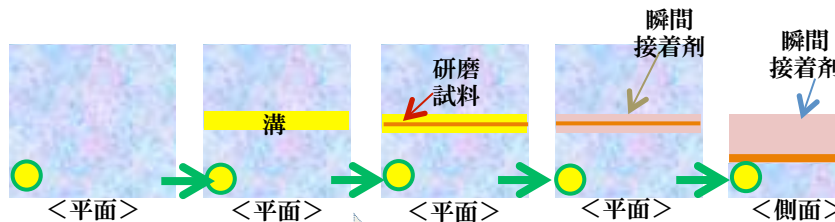
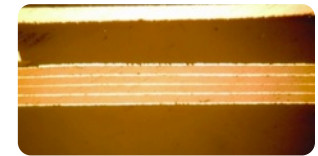
<断面研磨面>



対象試料:HDD用SUSPENSION PZ素子  
試料サイズ:L=3mm $\times$ 1.5mm  
研磨面:断面、平面



<PZ素子断面研磨面>



対象試料:微細糸半田  
試料サイズ:0.3mm  $\phi$   
研磨面:断面、平面

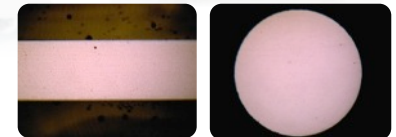
アクリル板に挟む

①.アクリル板に溝を掘り半田棒を埋め込みアロンアルファで固定する。



<1/2試料台の共削り>

<● 試料を貼り付ける>



対象試料:ファイバー端面研磨  
試料サイズ:150mm  $\phi$   
研磨面:断面、平面



アクリル板に挟む

